

Build-Up PCB Report 2014

世界プリント配線板市場に於ける動向

発行目的: 関係各社にプリント配線板市場の基礎情報を提供する事。

発行日: 平成 27 年 2 月 12 日 体裁: A4 判 483 頁三簡易製本

価格: 199,900 円 [税別] 215,892 円 [税込] 書籍のみ

価格: 219,900 円 [税別] 237,492 円 [税込] 書籍 + CD

第 1 章: 世界プリント配線板市場規模の推移及び予測

第 2 章: 世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率

第 3 章: 世界ビルドアップ基板市場規模の推移及び予測

第 4 章: 世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率

第 5 章: プリント配線板の応用分野

第 6 章: 企業事例

- ・ 市場規模の推移及び予測は、2011 年から 2018 年を対象としています。
- ・ 主要企業の市場占有率は、2013 年の実績値に基づいています。
- ・ 企業事例は、10 社を対象としています。

(株)ジャパンマーケティングサーベイ

〒103-0004 東京都中央区東日本 3-10-14

TEL: 03-5641-2871 FAX: 03-5641-0528

E-Mail: info@jms21.co.jp Web Site: <http://www.jms21.co.jp/>

【目次】

第1章 世界プリント配線板市場規模の推移及び予測

2013年に於ける世界プリント配線板市場の規模	3
数年間隔以内で訪れる市場規模の縮小	5
基板及びその基材の代表例	6
世界プリント配線板市場規模の推移及び予測:2011年～2018年	
1 層数別に於ける世界プリント配線板市場規模の推移及び予測:2011年～2018年	
1-1 全体市場	8
1-2 片面板市場	12
1-3 両面板市場	16
1-4 一般多層板市場(4層-10層)	20
1-5 一般多層板市場(12層-20層)	24
1-6 一般多層板市場(22層以上)	28
1-7 ビルドアップ基板市場	32
1-8 その他の基板市場	36
1-9 ICパッケージ基板市場	40
1-10 FPC & R-F 基板市場	44
2 応用分野別に於ける世界プリント配線板市場規模の推移及び予測:2011年～2018年	
2-1 全体市場	48
2-2 コンピュータ関連製品向けプリント配線板市場	52
2-3 通信装置向けプリント配線板市場	56
2-4 携帯電話向けプリント配線板市場	60
2-5 民生機器向けプリント配線板市場	64
2-6 車載機器向けプリント配線板市場	68
2-7 産業・医療・事務機器向けプリント配線板市場	72
2-8 航空宇宙・軍需関連製品向けプリント配線板市場	76
2-9 ICパッケージ基板市場	80
3 参考情報	
3-1 層数別に於ける基板単価の動向	84
3-2 応用分野別に於ける基板単価の動向	89

第2章 世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率

世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率:2013年

1 層数別による世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率:2013年(金額基準)	96
1-1 全体市場	98
1-2 マザーボード市場	99
1-3 一般多層板市場	100
1-4 片面板市場	101
1-5 両面板市場	102
1-6 一般多層板市場:4層 - 10層	103
1-7 一般多層板市場:12層 - 20層	104
1-8 一般多層板市場:22層以上	105
1-9 ビルドアップ基板市場	106
1-10 その他の基板市場	107
1-11 ICパッケージ基板市場	108
1-12 FPC 及びリジッドフレックス基板市場	109
2 層数別による世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率:2013年(数量基準)	110
2-1 全体市場	112

2-2	マザーボード市場	113
2-3	一般多層板市場	114
2-4	片面板市場	115
2-5	両面板市場	116
2-6	一般多層板市場:4層 - 10層	117
2-7	一般多層板市場:12層 - 20層	118
2-8	一般多層板市場:22層以上	119
2-9	ビルドアップ基板市場	120
2-10	その他の基板市場	121
2-11	ICパッケージ基板市場	122
2-12	FPC 及びリジッドフレックス基板市場	123
3	応用分野別による世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率:2013年(金額基準)	124
3-1	全体市場	126
3-2	コンピュータ関連製品向けプリント配線板市場	127
3-3	通信装置向けプリント配線板市場	128
3-4	携帯電話向けプリント配線板市場	129
3-5	民生機器向けプリント配線板市場	130
3-6	車載機器向けプリント配線板市場	131
3-7	産業・医療・事務機器向けプリント配線板市場	132
3-8	航空宇宙・軍需関連製品向けプリント配線板市場	133
3-9	ICパッケージ基板市場	134
4	応用分野別による世界プリント配線板市場に於ける主要企業の占有率:2013年(数量基準)	135
4-1	全体市場	137
4-2	コンピュータ関連製品向けプリント配線板市場	138
4-3	通信装置向けプリント配線板市場	139
4-4	携帯電話向けプリント配線板市場	140
4-5	民生機器向けプリント配線板市場	141
4-6	車載機器向けプリント配線板市場	142
4-7	産業・医療・事務機器向けプリント配線板市場	143
4-8	航空宇宙・軍需関連製品向けプリント配線板市場	144
4-9	ICパッケージ基板市場	145
5	参考情報	
5-1	各社の層数別に於ける単価の動向	146
5-2	各社の応用分野別に於ける単価の動向	147

第3章 世界ビルドアップ基板市場規模の推移及び予測

2013年に於ける世界ビルドアップ基板市場の規模	149
2013年に於ける世界ビルドアップ基板市場規模の内訳	150
ビルドアップ基板の種類	151
世界ビルドアップ基板市場規模の推移及び予測:2011年～2018年	
1 層数別に於けるビルドアップ基板市場規模の推移及び予測:2011年～2018年	
1-1 全体市場	154
1-2 ベース基板型一段積み	158
1-3 ベース基板型二段積み	162
1-4 ベース基板型三段積み	166
1-5 ベース基板型四段積み以上	170
1-6 全層IVH型2層	174
1-7 全層IVH型4層	176
1-8 全層IVH型6層	180
1-9 全層IVH型8層	184
1-10 全層IVH型10層	188
1-11 全層IVH型12層以上	192

1-12	一括積層型 2 層-10 層	196
1-13	一括積層型 12 層-20 層	198
1-14	一括積層型 22 層-30 層	202
1-15	一括積層型 32 層-40 層	204
1-16	一括積層型 42 層-50 層	206
1-17	一括積層型 52 層以上	208
1-18	ベース基板型 IC パッケージ基板	212
1-19	全層 IVH 型 IC パッケージ基板	216
1-20	一括積層型 IC パッケージ基板	220
2	応用分野別に於ける世界ビルドアップ基板市場規模の推移及び予測:2011 年~2018 年	
2-1	全体市場	222
2-2	コンピュータ関連製品向けビルドアップ基板市場	226
2-3	通信装置向けビルドアップ基板市場	230
2-4	携帯電話向けビルドアップ基板市場	234
2-5	民生機器向けビルドアップ基板市場	238
2-6	車載機器向けビルドアップ基板市場	242
2-7	産業・医療・事務機器向けビルドアップ基板市場	246
2-8	航空宇宙・軍需関連製品向けビルドアップ基板市場	250
2-9	ビルドアップ型 IC パッケージ基板市場	254
3	参考情報	
3-1	層数別に於けるビルドアップ基板の単価動向	258
3-2	応用分野別に於けるビルドアップ基板の単価動向	264

第 4 章 世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率

世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年

1	種類別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年(金額基準)	272
2	種類別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年(数量基準)	276
3	参考情報:各社の種類別に於ける単価の動向	280
4	層数別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年(金額基準)	281
4-1	ベース基板型一段積み市場	283
4-2	ベース基板型二段積み市場	284
4-3	ベース基板型三段積み市場	285
4-4	ベース基板型四段積み以上の市場	286
4-5	全層 IVH 型 2 層市場	287
4-6	全層 IVH 型 4 層市場	287
4-7	全層 IVH 型 6 層市場	288
4-8	全層 IVH 型 8 層市場	289
4-9	全層 IVH 型 10 層市場	290
4-10	全層 IVH 型 12 層以上の市場	291
4-11	一括積層型 2 層-10 層市場	292
4-12	一括積層型 12 層-20 層市場	292
4-13	一括積層型 22 層-30 層市場	293
4-14	一括積層型 32 層-40 層市場	293
4-15	一括積層型 42 層-50 層市場	293
4-16	一括積層型 52 層以上の市場	294
4-17	ベース基板型 IC パッケージ基板市場	295
4-18	全層 IVH 型 IC パッケージ基板市場	296
4-19	一括積層型 IC パッケージ基板市場	296
5	層数別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年(数量基準)	297
5-1	ベース基板型一段積み市場	299
5-2	ベース基板型二段積み市場	300
5-3	ベース基板型三段積み市場	301

5-4	ベース基板型四段積み以上の市場	302
5-5	全層 IVH 型 2 層市場	303
5-6	全層 IVH 型 4 層市場	303
5-7	全層 IVH 型 6 層市場	304
5-8	全層 IVH 型 8 層市場	305
5-9	全層 IVH 型 10 層市場	306
5-10	全層 IVH 型 12 層以上の市場	307
5-11	一括積層型 2 層-10 層市場	308
5-12	一括積層型 12 層-20 層市場	308
5-13	一括積層型 22 層-30 層市場	309
5-14	一括積層型 32 層-40 層市場	309
5-15	一括積層型 42 層-50 層市場	309
5-16	一括積層型 52 層以上の市場	310
5-17	ベース基板型 IC パッケージ基板市場	311
5-18	全層 IVH 型 IC パッケージ基板市場	312
6	層数別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の単価動向:2013 年	313
7	応用分野別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年(金額基準)	314
7-1	コンピュータ関連製品向けビルドアップ基板市場	316
7-2	通信装置向けビルドアップ基板市場	317
7-3	携帯電話向けビルドアップ基板市場	318
7-4	民生機器向けビルドアップ基板市場	319
7-5	車載機器向けビルドアップ基板市場	320
7-6	産業・医療・事務機器向けビルドアップ基板市場	321
7-7	航空宇宙・軍需関連製品向けビルドアップ基板市場	322
7-8	ビルドアップ型 IC パッケージ基板市場	323
8	応用分野別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の占有率:2013 年(数量基準)	324
8-1	コンピュータ関連製品向けビルドアップ基板市場	326
8-2	通信装置向けビルドアップ基板市場	327
8-3	携帯電話向けビルドアップ基板市場	328
8-4	民生機器向けビルドアップ基板市場	329
8-5	車載機器向けビルドアップ基板市場	330
8-6	産業・医療・事務機器向けビルドアップ基板市場	331
8-7	航空宇宙・軍需関連製品向けビルドアップ基板市場	332
8-8	ビルドアップ型 IC パッケージ基板市場	333
9	応用分野別による世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の単価動向:2013 年	334
10	世界ビルドアップ基板市場に於ける上位 20 社の売上一覧:2013 年	
10-1	金額基準	335
10-2	数量基準	343
10-3	単価動向	351

第 5 章 プリント配線板の応用分野

1	サーバ向けプリント配線板の世界市場動向	
1-1	サーバの製品概要	361
1-2	世界サーバ市場の動向	
1-2-1	世界サーバ市場規模の推移及び予測:2011 年~2018 年	364
1-2-2	世界サーバ市場に於ける各社の占有率:2013 年	366
1-2-3	世界サーバ市場に於ける価格動向:2013 年	368
1-3	世界サーバ向けプリント配線板市場の動向	
1-3-1	世界サーバ向けプリント配線板市場規模の推移及び予測:2011 年~2018 年	369
1-3-2	世界サーバ向けプリント配線板市場に於ける各社の占有率:2013 年	370
1-3-3	サーバ向けプリント配線板及び基材の概要	372

2 自動車向けプリント配線板の世界市場動向

2-1 車載機器の概要	375
2-2 自動車市場の動向	
2-2-1 自動車市場規模の推移及び予測:2012 年～2018 年	376
2-2-2 主要自動車メーカーの生産実績:2013 年	377
2-3 自動車向けプリント配線板市場の動向	
2-3-1 自動車向けプリント配線板の概要	378
2-3-2 自動車向けプリント配線板市場規模の推移及び予測:2012 年～2018 年	379
2-3-3 自動車向けプリント配線板市場に於ける各社の占有率:2013 年	381
2-3-4 自動車向けビルドアップ基板の市場動向	383

3 モバイル向けプリント配線板の世界市場動向

3-1 モバイル市場の動向	
3-1-1 携帯電話市場規模の推移及び予測	385
3-1-2 主要携帯電話メーカーの販売実績	386
3-1-3 タブレット PC 市場動向	387
3-2 モバイル用ビルドアップ基板の動向	
3-2-1 主要メーカーのモバイル向けメイン基板	388
3-2-2 モバイル向けプリント配線板市場規模の推移及び予測:2012 年～2018 年	391
3-2-3 モバイル向けビルドアップ基板における各社の占有率	393

第 6 章 企業事例

・AT & S (Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft)	397
・日本シイエムケイ株式会社	407
・Compeq Manufacturing Co. Ltd.	412
・Daeduck Group	426
・株式会社デンソー	432
・イビデン株式会社	447
・株式会社メイコー	452
・Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	457
・新光電気工業株式会社	463
・TTM Technologies, Inc.	468

【内容見本】

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

同様の形式にて
纏めております。

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

Unit: TSQM

金額単位(百万米ドル)
数量単位(千平米)

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

平米単価(米ドル単位)

対前年比(%)

片面板、両面板、...、
FPC & RF基板も

PCB	Application Fields	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Computer-Related Products								
	Communication Devices								
	Infrastructure-Related Equipment								
	Cellular Phones								
	Consumer Electronics								
	Automotive Electronics								
	Industry, Medical, & Office Appliances								
TOTAL	Military & Aerospace Equipment								
	IC Packages								

(Estimated by JMS)

PCB	Layer Count	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Single-Sided Motherboards								
	Double-Sided Motherboards								
	Conventional 4-Layer to 10-Layer Boards								
	Multilayer 12-Layer to 20-Layer Boards								
	Motherboards 22-Layer & Higher-Layer Boards								
	Laser Microvia Motherboards								
	The Other Motherboards*								
IC Package Substrates									
FPC & R-F PCB									
TOTAL									

PCB	Layer Count	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Single-Sided Motherboards								
	Double-Sided Motherboards								
	Conventional 4-Layer to 10-Layer Boards								
	Multilayer 12-Layer to 20-Layer Boards								
	Motherboards 22-Layer & Higher-Layer Boards								
	Laser Microvia Motherboards								
	The Other Motherboards*								
IC Package Substrates									
FPC & R-F PCB									
TOTAL									

PCB	Layer Count	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Single-Sided Motherboards								
	Double-Sided Motherboards								
	Conventional 4-Layer to 10-Layer Boards								
	Multilayer 12-Layer to 20-Layer Boards								
	Motherboards 22-Layer & Higher-Layer Boards								
	Laser Microvia Motherboards								
	The Other Motherboards*								
IC Package Substrates									
FPC & R-F PCB									
TOTAL									

同様の形式にて
纏めております。

平米単価(米ドル単位)

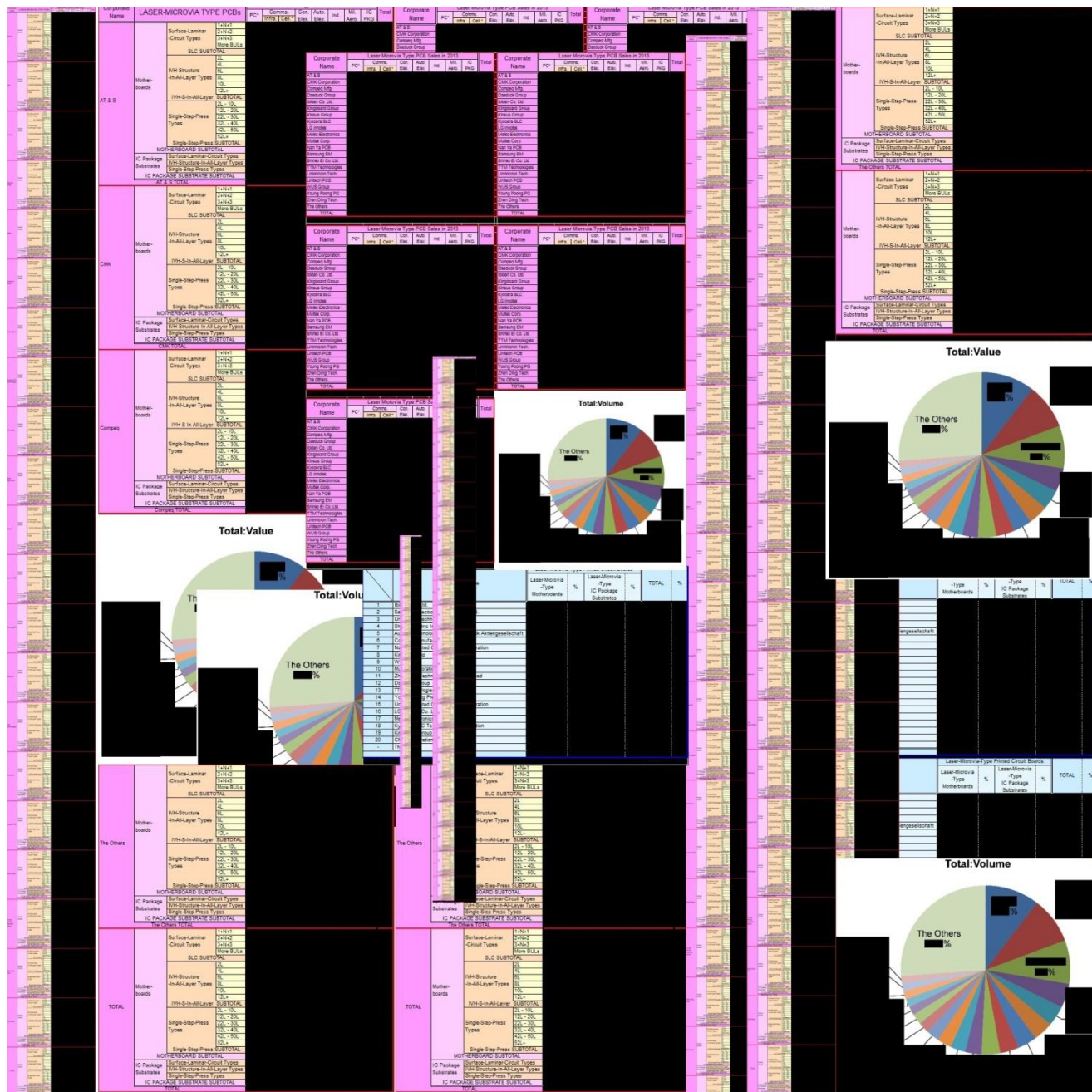
対前年比(%)

金額単位(百万米ドル)
数量単位(千平米)

PC、通信、...、
IC PKG基板も

PCB	Layer Count	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL	Single-Sided Motherboards								
	Double-Sided Motherboards								
	Conventional 4-Layer to 10-Layer Boards								
	Multilayer 12-Layer to 20-Layer Boards								
	Motherboards 22-Layer & Higher-Layer Boards								
	Laser Microvia Motherboards								
	The Other Motherboards*								
IC Package Substrates									
FPC & R-F PCB									
TOTAL									

(Estimated by JMS)



【申込書】

FAX TO: 03 - 5641 - 0528 (0120-052-807)

平成 年 月 日

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ 殿

Build-Up PCB Report 2014

申込企業名:

申込責任者: 印

同役職:

連絡担当者:

同所属:

〒 所在地:

TEL: FAX:

E-Mail:

申込金額 円(税込み)

【守秘契約書】 CD 版をご希望の場合、下記空欄にお会社名及びお申込責任者様のお名前をご記入下さいませ。

は、上記調査資料の内容を第三者に対し

意図的に漏洩致しません。 印

<連絡事項>

【備考】本調査報告書(Build-Up PCB Report 2014)は、次月号(PCB Report 2015)と一括購入なされる場合、一括購入割引が適用されます。その場合、二冊にて 360,000 円(税別)・388,800 円(税込み)となります。尚、一括購入される場合、CD はご希望により贈呈致します。詳細は、弊社ウェブサイトをご覧下さいませ。